

사양서

품명	(영문) 2026 AsiaPac Adv TCAD University Bundle (국문) 2026 아시아 태평양 지역 대학교 TCAD		
모델명	TCAD University Bundle		
수량	40 copy	정부물품분류번호(10자리)	4323349901

1. 규격

I. 용도

반도체의 물성과 소자 동작을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 이해하고 분석하는 Tool을 확보하여 교육에 사용하기 위함.

II. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 본체(Mind body) : License text file
2. Accessories :
 - 1) 2026 AsiaPac Adv TCAD University Bundle 40 copy

III. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1. 설치 및 지원은 Synopsys사의 End User License & Support Agreement에 준한다.
2. 검수는 시놉시스사의 라이선스 파일로 실시하며, 30일 이내에 종결하여야 한다.
3. 본 제품은 대학 교육용이다.

2. 필수확인내용

- 1) 납기조건: 계약일로부터 1주 이내
- 2) 설치조건: 지정장소에 설치 후, Network상의 교육에 지장이 없어야 한다.
- 3) 하자보증기간: 계약일로부터 1년
- 4) 훈련조건: 교육 교재 파일 제공